

課題番号 : F-14-IT-0020
利用形態 : 技術相談
利用課題名(日本語) : 絶縁樹脂上での微細銅配線形成
Program Title (English) : Fabrication of fine copper wiring on insulating resin
利用者名(日本語) : 田中 俊章¹⁾,
Username (English) : Toshiaki Tanaka¹⁾
所属名(日本語) : 1) 積水化学工業株式会社 R&D センター IM プロジェクト
Affiliation (English) : 1) IM Project, R&D center, Sekisui Chemical Co., Ltd.

1. 概要(Summary)

絶縁樹脂上での銅配線形成について、マスクレス露光機の利用を検討しており、露光機メーカーである大日本化科研から東京工業大学にマスクレス露光機を納入していることから、ナノプラットフォームで試験可能ということを紹介されてきた。

技術代行で申込み、覚書交換までを行った。実際の作業の前段階として、技術相談を行った。まず、先方の目標などの説明を受けた後、先方の希望のアプリケーションに対し、必要なプロセス装置などを紹介し、リフトオフプロセスなどに必要なレジスト(AZ レジスト)などの特性を説明した。また、実際の作業において検討が必要な部分(樹脂にレジストを塗布した際の特性検討)を議論の上、明らかにし、実際の実験計画の立案を行った。

ただし、その時にはマスクレス露光機立ち上げの最中であったため、位置合わせ機能がきちんとまだ動いていなかった。最終的にマスクレス露光機の位置合わせ機能の立ち上がりは秋以降になったことから、立ち上がり時に連絡をしたが、そのときに先方の都合により利用の希望は無かった。

2. 実験(Experimental)

< 技術相談のため概要のみ記載。以下、空欄。 >

3. 結果と考察(Results and Discussion)

< 技術相談のため概要のみ記載。以下、空欄。 >

4. その他・特記事項(Others)

なし

5. 論文・学会発表(Publication/Presentation)

なし

6. 関連特許(Patent)

なし